

证券代码：301269

证券简称：华大九天

编号：2024-001

## 北京华大九天科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	中信证券、海通证券、申万宏源、UBS、招商证券、摩根士丹利亚洲有限公司、华夏基金、诺安基金、国新投资、银华基金、国金证券、华福证券、嘉实基金、长盛基金、北京诚旻投资有限公司、九泰基金、招商基金、中邮创业基金、润晖投资、东北证券、中金公司、中银基金、东吴基金、工银瑞信基金、太平基金、西部证券、交银国际信托、荷荷（北京）私募基金管理有限公司、上海懿坤资产管理有限公司、上海景林股权投资管理有限公司、上海留仁资产管理有限公司、北京勤益科技投资管理有限公司、盈泰明道股权投资基金有限公司、景泰利丰资产管理有限公司、上海顶天投资有限公司、兴业基金、国融证券、百川财富（北京）投资管理有限公司、深圳前海博普资产管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海天貌投资、上海众行远私募基金管理有限公司、杭州长谋投资管理有限公司、上海趣时资产管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、深圳市三木投资有限公司、上海东岭股权投资有限公司、国富联合（青岛）私募基金管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、上海玖歌投资管理有限公司、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
时间	2024年4月29日 15:00-16:00
地点	公司会议室(在线访谈)
形式	在线访谈
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务负责人：刘二明 副总经理、董事会秘书：宋矗林 证券事务代表：吴雪丽 投资者关系经理：王梦颖

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公司介绍（略）</p> <p>问答环节：</p> <p><b>1、请介绍公司 2023 年和 2024 年一季度业绩情况</b></p> <p>答：2023 年公司实现营业收入 10.1 亿元，同比增长 27%，其中 EDA 软件销售收入 9.05 亿，同比增长 34%，占总收入的 90%。毛利率方面，随着技术提升和交付流程不断完善，技术服务毛利率水平逐步提高，整体毛利率上升至 94%。公司继续保持了较高的研发投入，研发费用约 6.8 亿元，占营业收入的比例为 68%，较上年增加 7 个百分点。2023 年公司实现净利润约 2 亿元，同比增长 8%，扣除非经常性损益后，净利润增速为 102%。</p> <p>2024 年一季度公司实现营业收入 2.1 亿元，在上年同期高速增长的基础上实现了 34% 的快速增长；实现净利润 767 万元，同比下滑 63.75%，主要原因是一季度计提确认股份支付金额 5071.68 万，该因素对一季度净利润影响较大。</p> <p><b>2、请介绍公司 2023 年新推出产品情况</b></p> <p>答：2023 年公司新推出了存储电路设计全流程工具系统和射频电路设计全流程工具系统。其中存储电路设计全流程工具系统已经应用于国内头部存储器芯片设计厂商，射频电路设计全流程工具系统已经应用于硅基射频及化合物射频领域的头部企业。目前公司已经形成八大业务领域，包括七个 EDA 产品矩阵及技术服务业务。</p> <p>数字电路设计 EDA 工具方面，公司继续提升全流程工具覆盖率，新推出了数字前端逻辑综合工具。</p> <p>晶圆制造 EDA 工具方面，新推出了光刻掩膜版数据处理与验证分析平台，该平台提供了强大的工具套件，主要用于版图数据切割转档、掩膜版数据验证、掩膜版数据查看与分析等方面。</p> <p>除了上述工具软件之外，公司 2023 年开展了基础 IP 业务，为众多客户提供了 IP 解决方案，成功支持了客户的产品</p>
----------------------	---

设计及流片。

### **3、公司全流程工具的拓展思路是什么？**

答：公司的愿景是致力于成为全流程、全领域、全球领先的 EDA 提供商，为我国集成电路产业持续健康发展提供支撑和保障。

从拓展思路来看，我们短期目标是重点补齐集成电路设计和晶圆制造关键环节核心 EDA 工具产品短板，同时加强对既有工具先进工艺支持能力。进一步加大设计、仿真、验证等核心技术研发，与产业协同实现集成电路设计工具全流程覆盖、晶圆制造和封测覆盖关键领域，部分产品达到国际领先水平；中期目标是完成集成电路设计工具系统的开发和市场推广，全面实现设计类工具国产化替代，同时更多产品达到国际领先水平。与产业协同实现制造、封测工具全流程覆盖，支持国内最先进工艺；长期目标是全面实现集成电路设计、制造和封测领域的 EDA 工具全流程国产化替代，多个产品达到国际领先水平，成为全球 EDA 行业的领导者。

### **4、新思科技推出 AI 全站式应用，请问公司认为 AI 如何赋能 EDA 产品？**

答：近年来，伴随芯片设计基础数据规模的不断增加、系统运算能力的阶跃式上升，人工智能技术在 EDA 领域的应用出现了新的发展契机。另一方面，芯片复杂度的提升以及设计效率需求的提高同样要求人工智能技术赋能 EDA 工具的升级，辅助降低芯片设计门槛、提升芯片设计效率。公司已将人工智能技术应用于现有产品中。

### **5、公司做 IP 业务的发展思路和优势是什么？**

答：IP 是芯片设计行业上游供应链中技术含量最高的关键环节，由于其性能高、设计复杂、技术密集度高、知识产权集中、商业价值昂贵等因素，已经逐渐成为集成电路行业的关键要素和核心竞争力。公司 IP 业务的优势主要体现在客户端和

	<p>产品端：在客户端，需要 IP 的产线同样需要 EDA 工具，所以我们面对的是同一类客户；在产品端，EDA 工具和 IP 之间又有协同性，因此从这两方面来讲我们还是有一定优势的。</p> <p><b>6、公司对人员及研发人员数量的长期规划是什么？</b></p> <p>答：EDA 行业对于专业人才尤其是研发人员的依赖程度较高，专业技术人员是公司生存和发展的重要基石。去年公司人员增速较高，从 728 人增长至 1023 人，增速超过 40%。今年我们会继续保持人员的增长，但是增速方面需要根据业务需求来决定。总体来讲，我们希望营业收入增速方面和我们的人员增速方面保持一个动态的平衡。</p> <p><b>7、公司晶圆制造产品布局的思路是什么？会把每个点都做完整还是会有所侧重？</b></p> <p>答：我们以前业务重点是在设计类 EDA 工具，晶圆制造领域 2018 年才开始布局，我们的整体思路是要把晶圆制造的主流 EDA 工具全线补齐。目前我们在晶圆制造 EDA 的多个细分领域形成了多个解决方案，包括 PDK 套件开发方案、标准单元库和 SRAM 等基础 IP 的完整工具链支撑方案、光刻掩膜版数据准备和分析验证方案、物理规则验证和可制造性检查方案等，为晶圆制造厂提供了重要的工具和技术支撑。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 29 日